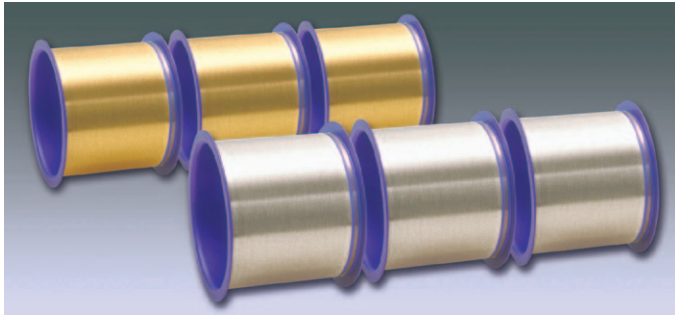


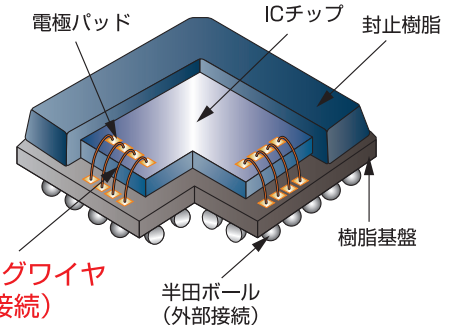
# ボンディングワイヤ



当社製品は、細線化、ロングスパン化、ファインピッチ化等、ボンディング技術の限界に挑戦できるワイヤです。

These wires enable us to challenge the limits of bonding technologies through thinner wires, longer spans and finer pitches.

ボンディングワイヤは、半導体素子の電気信号を半導体パッケージ外部に伝えるための接続材料です。



## Cu ワイヤ

## Cu Wire

シリーズ Series

表面にPdコーティングを施したCuワイヤです。ロングスパン、ファインピッチにも対応できるワイヤです。



The Cu wires which have Pd coated surfaces. These wires are suitable for longer spans, finer pitches.

Pat. No.	JP 4542203	KR 10-1030838	TW I342809	<b>48 Patents have been granted in 12 Countries</b>
	US 8.102.061	SG 158579	CN ZL200980100379.0	

## Au 4N系ワイヤ (Au純度 $\geq 99.99\%$ )

## Au 4N Series Wire (Au purity $\geq 99.99\%$ )

ロングスパン、ファインピッチ、細線化に最適なワイヤです。

- ・ワイヤスパン：7mm
- ・ループ高さ：90 $\mu\text{m}$
- ・破断強度 ( $\Phi 25\mu\text{m}$ )：147mN (15gf)



These wires are suitable for longer spans, finer pitches and thinner wires.  
Wire span : 7mm  
Loop height : 90 $\mu\text{m}$   
Rapture strength ( $\Phi 25\mu\text{m}$ ) : 147mN (15gf)

ロングスパン・BGA用台形短スパン等汎用性の高いワイヤです。



These wires are widely used for general purposes as long spans, BGA trapezoidal short spans, etc.

## Au 合金系ワイヤ (Au純度 $\geq 99\%$ )

## Au Alloy Series Wire (Au purity $\geq 99\%$ )

4N系ワイヤのパラメータでボンディング可能な長期接合信頼性に優れたワイヤです。



These wires can be bonded with the parameters of 4N series wires and are highly reliable for long-term bonding.

